

安徽工业强基项目申报 安徽电子信息工业企业申报投资指南

产品名称	安徽工业强基项目申报 安徽电子信息工业企业申报投资指南
公司名称	安徽杏仁桉工业项目咨询服务有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:安徽杏仁桉 型号:aaa 尺寸:12
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区尚泽大都会C座3010室
联系电话	15955176488 13965134111

产品详情

安徽工业强基项目申报——电子信息工业企业投资申报指南电子信息行业工业企业注意：

（一）核心基础零部件（元器件）

1. 高性能芯片。CPU芯片（含嵌入式）、存储器芯片、FPGA及动态重构芯片、高集成度SOC芯片、毫米波雷达/激光雷达/摄像头等核心传感器芯片、高速AD/DA等。

2. 新型显示器件。高分辨率TFT-LCD显示器件、低温多晶硅TFT-LCD显示器件、金属氧化物TFT-LCD显示器件；AMOLED（低温多晶硅背板）、AMOLED（金属氧化物背板）、柔性AMOLED等新型显示器件。开展布局全息、激光等显示技术以及碳基、量子点等新型显示技术研发。

3. 元器件。量子通信、量子计算专用器件。超小型片式多层陶瓷电容器、超小型片式电阻器、片式固态

铝电解电容器、片式钽电容器、超小型片式电感器、小型片式压电频率器件（石英晶体器件及压电陶瓷器件）、集成无源器件、低成本/小型化/高性能的滤波器等。功率场效应晶体管（MOSFET）、快恢复二极管（FRD）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、集成门级换流晶闸管（IGCT）、肖特基二极管等新型电力电子器件。大功率模块、智能功率模块（IPM）和用户专用功率模块（ASPM）等。硅基光电子器件、碳化硅、氮化镓、砷化镓等宽禁带电力电子、射频器件。高阶积层板、IC基板、埋置元件板等高密度互连（HDI）板、特种印制板（高频板、金属基板和厚铜箔板）、发光二极管（LED）用印制板、印制电子和光电印制板。微型化、集成化、智能化、网络化传感器，具有无线通信、传感、数据处理功能的无线传感器网络节点。直流无刷电机及智能化微特电机以及为机器人配套的减速器、伺服电机等。高电压、大容量、大电流、高可靠、长寿命真空开关管及专用真空器件。大功率半导体激光器、高功率气体激光器、光纤激光器、紫外激光器。高性能的红外焦平面器件、高分辨率InGaAs探测器。基于100G/400G的超低损耗光纤、光纤激光用工业级双包层掺镱光纤、核电用耐辐照光纤光缆；海缆中继器、光纤预制棒、光互连用模块、光背板及光电元器件；新型通信设备用56Gbps高速连接器以及继电器、滤波器、线缆组件。为新能源产业配套的新型储能电池、超级电容器、为新能源汽车配套的高压直流继电器、特种功率电阻器以及电力电子用关键电子元器件。超级电容器及与电池混合应用，超级电容器生产设备。高能量密度、长循环寿命、高安全性的消费型、动力型和储能型锂离子电池，大容量锂离子电池系统集成和产业化，大容量电池组管理系统。新型、高性能、高安全性的正负极材料、隔膜材料、电解质、溶剂、添加剂、铝塑膜材料。燃料电池材料，小型实用燃料电池，小型燃料电池系统应用。

（二）先进基础工艺

20-14nm集成电路制造工艺、HK金属栅工艺、鳍式场效应晶体管工艺、CPU专用工艺、存储器超精密工艺；LTPS、Oxide背板量产工艺，AMOLED背板、蒸镀和封装等工艺，柔性显示相关工艺。大功率、高亮度LED外延片和芯片制造工艺。

（三）基础材料。

8~12英寸单晶硅及硅片，40~22nm集成电路用8~12英寸抛光片、外延片和SOI片及SiGe/Si外延片，金属有机源（MO）、高纯气体；砷化镓、碳化硅、磷化铟、锗等第二、第三代半导体材料；半导体抛光材料（抛光液、抛光垫、抛光布）；高密度封装用蚀刻引线框架。电力电子器件用8英寸高阻区熔硅单晶及晶片、陶瓷覆铜板、铝碳化硅基板、管壳等。千吨级电子级多晶硅量产；高质量、高效率单晶硅、单晶锗片生产工艺，硅片薄型化技术；坩埚、高纯石墨、高纯石英砂、碳碳复合材料、玻璃、背板等材料。提高并稳定铜铟镓硒、铜铟硫、碲化镉等薄膜光伏材料性能。高质量氮化镓、碳化硅、硅衬底材料及高亮度、大功率芯片材料生长技术；大尺寸AMOLED显示及照明用高性能有机发光材料；大尺寸蓝宝石晶片生长加工技术；封装用高性能环氧树脂、硅胶、高品质荧光粉、高亮度、大功率LED用高纯贵金属及合金蒸发材料、高纯气体等。大尺寸锗系材料、硫化锌（ZnS）、硒化锌（ZnSe）、碳化硅（SiC）红外材料。高世代大尺寸TFT-LCD面板用玻璃基板、柔性玻璃基板；混合液晶和相关单体材料、智能调光窗户用分散液晶材料，偏光片及相关光学薄膜材料、彩色滤光片及彩色光刻胶材料、大尺寸高精度掩模板、有机发光材料等材料；大尺寸金属靶材、旋转靶及氧化物靶材；高纯电子气体和试剂等配套材料。高密度覆铜板及电子铜箔材料，CMOS及SAW模块用陶瓷封装材料、压电与系统信息处理材料；高热导率氮化铝陶瓷粉体材料；片式超薄介质高容电子陶瓷材料；高端电子浆料；低温共烧陶瓷（LTCC）多层基板、低损耗电容器纸；超级电容器用石墨烯材料、燃料电池用稀土掺杂高离子电导率陶瓷粉体及隔膜片、高性能磁性材料。高阶积层印刷电路板、IC基板、埋置元件板等高密度互连（HDI）板技术、特种印制板、LED用高导热基板印制电子和光电印制板等。适用于光纤宽带网络的低成本光纤光缆、光纤预制棒；用于高速率、大容量、长距离光传输网络的新一代超低衰减大有效面积单模光纤及光纤预制棒用石英套管、掺稀土特种光纤、光子晶体光纤、光纤涂覆树脂等。长寿命大电流密度（ $D > 150A/cm^2$ ）阴极材料、触头材料、一致性优良的 Al_2O_3 陶瓷和封接组件，高热导率（ $>190W/mk$ ） AlN 粉体、替代氧化铍陶瓷夹持杆材料、钨钼窄带材料、大功率真空电子器件用高强度无氧铜。高世代玻璃基板、偏光板、液晶、OLED发光材料、大尺寸高精度掩模板驱动芯片、靶材、特气和化学品等关键显示用材料。

（四）强基平台建设

1. 重点行业领域关键共性基础工艺平台。建立管理应用平台，研究全产业链间不同产品和系统的互通互用；建立电子材料应用认证平台；材料技术标准研究和制定平台，电子材料知识产权专利池平台等。

2. 重点产业领域“四基”公共服务平台。建立传感器产业***公共服务平台，向企业提供典型业务应用技术示范及产品第三方检测服务；完善包括多晶硅、电池片和组件、薄膜电池的检测及光伏应用系统的检测、认证等公共服务平台建设。支持相关服务平台开展行业共性问题研究，制订和推广行业标准，光伏系统工程的验收等。

3. 基础软件。服务器操作系统、桌面操作系统、智能移动终端操作系统等。通用数据库管理系统、分析性数据库管理系统、实时数据库管理系统、内存数据库管理系统等。应用服务器、消息中间件、交易中间件等。高效虚拟化软件、智能海量数据存储与管理系统、分布式应用支撑平台等。网络化办公套件、新一代搜索引擎及浏览器等基础软件。

欢迎留言咨询，建议拨打电话了解更多详细内容！！！！